

MEMS/MOEMS封装技术-概念.设计.材料及工艺



[MEMS/MOEMS封装技术-概念.设计.材料及工艺_下载链接1](#)

著者:肯·吉列奥

出版者:7-122

出版时间:2008-1

装帧:

isbn:9787122015181

《MEMS/MOEMS封装技术:概念、设计、材料及工艺》是国际上较系统全面阐述MEMS/

MOEMS封装的著作，作者是微电子封装界的知名专家、美国表面组装协会的董事。《MEMS/MOEMS封装技术:概念、设计、材料及工艺》主要介绍MEMS/MOEMS封装技术的最新进展，以及工艺的共性、个性和可靠性。针对高成本的封装，《MEMS/MOEMS封装技术:概念、设计、材料及工艺》给出了全面的解决方案，内容全面、系统、新颖。

微电子机械系统（MEMS）是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。它具有微型化、智能化、多功能、高集成度和适于大批量生产等特点。微光电子机械系统（MOEMS）是一种将MEMS技术引进到光电子中的新应用。近几年，MEMS/MOEMS技术的迅速发展使其在汽车、医疗、通信及其他消费类电子产品中获得了广泛的应用。但影响MEMS/MOEMS技术飞速发展的关键，就是封装技术。

作者介绍:

目录:

[MEMS/MOEMS封装技术-概念.设计.材料及工艺_下载链接1](#)

标签

封装

半导体

评论

[MEMS/MOEMS封装技术-概念.设计.材料及工艺_下载链接1](#)

书评

[MEMS/MOEMS封装技术-概念.设计.材料及工艺_下载链接1](#)